

2024年 6月25日

委員各位殿

一般社団法人 溶接学会
マイクロ接合研究委員会
委員長 福本信次
(公印省略)

マイクロ接合研究委員会 開催通知

第146回マイクロ接合研究委員会を下記の通り開催致しますので、万障お繰り合せの上
ご出席下さいますようお願い申し上げます。

出欠は7月12日(金)までにお知らせ下さい

記

- 日時 2024年(令和6年) 7月 19日(金) 10:30~16:30
- 場所 大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 913会議室
東京都中央区日本橋本町二丁目3番11号 日本橋ライフサイエンスビルディング9階
- 幹事会のご案内
幹事会を12:00~開催いたしますので、幹事または代理の方はご出席下さいますようお願い申し上げます。会場は911会議室です。

【出欠・事務関連の連絡先】

一般社団法人溶接学会 事務局 木暮
E-mail: s_kogure@tt.rim.or.jp TEL: 03-5825-4073

第146回マイクロ接合研究委員会
プログラム

日 時： 2024年 7月 19日(金) 10:30～16:30

場 所： 大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 913 会議室(東京 日本橋)

時 間	題 目	講 演 者
司 会 中島 泰 (三菱電機)		
10:30～11:15	『アルミニウム/銅異材継手を用いた 分離可能な異材接合技術開発の検討』 (資料番号MJ-858-2024)	大阪大学 ○小椋智、中島弘貴、 清水万真、廣瀬明夫 三菱マテリアル株式会社 谷口兼一、村中亮
11:15～12:00	『酸素燃焼を用いて製造した 銅ナノ粒子のパワー半導体接合材への適用検討』 (資料番号MJ-859-2024)	大陽日酸株式会社 ○三好健太朗、高田克則、 五十嵐弘
12:00～13:00	昼 食 休 憩	
13:00～13:10	委 員 会 議 事	
司 会 小椋 智 (大阪大学)		
13:10～13:55	『爆発圧着法による軽金属材料の接合及び特性評価』 (資料番号MJ-860-2024)	名古屋工業大学 ○成田麻未、佐藤尚、渡辺義見 産業技術総合研究所 Bian Mingzhe、千野靖正
13:55～14:40	『大電流パワーモジュールのための高信頼接合技術の研究』 (資料番号MJ-861-2024)	東芝デバイス&ストレージ株式会社 ○川城史義
14:40～15:00	休 憩	
司 会 木下 慶人 (富士電機)		
15:00～15:45	『焼結型接合向け液体急冷 Ag 合金の提案』 (資料番号MJ-862-2024)	大阪大学産業科学研究所 ○中山幸仁
15:45～16:30	『金属異種材接合技術 DLAMP®』 (資料番号MJ-863-2024)	ダイセルミライズ(株) ○清水潔

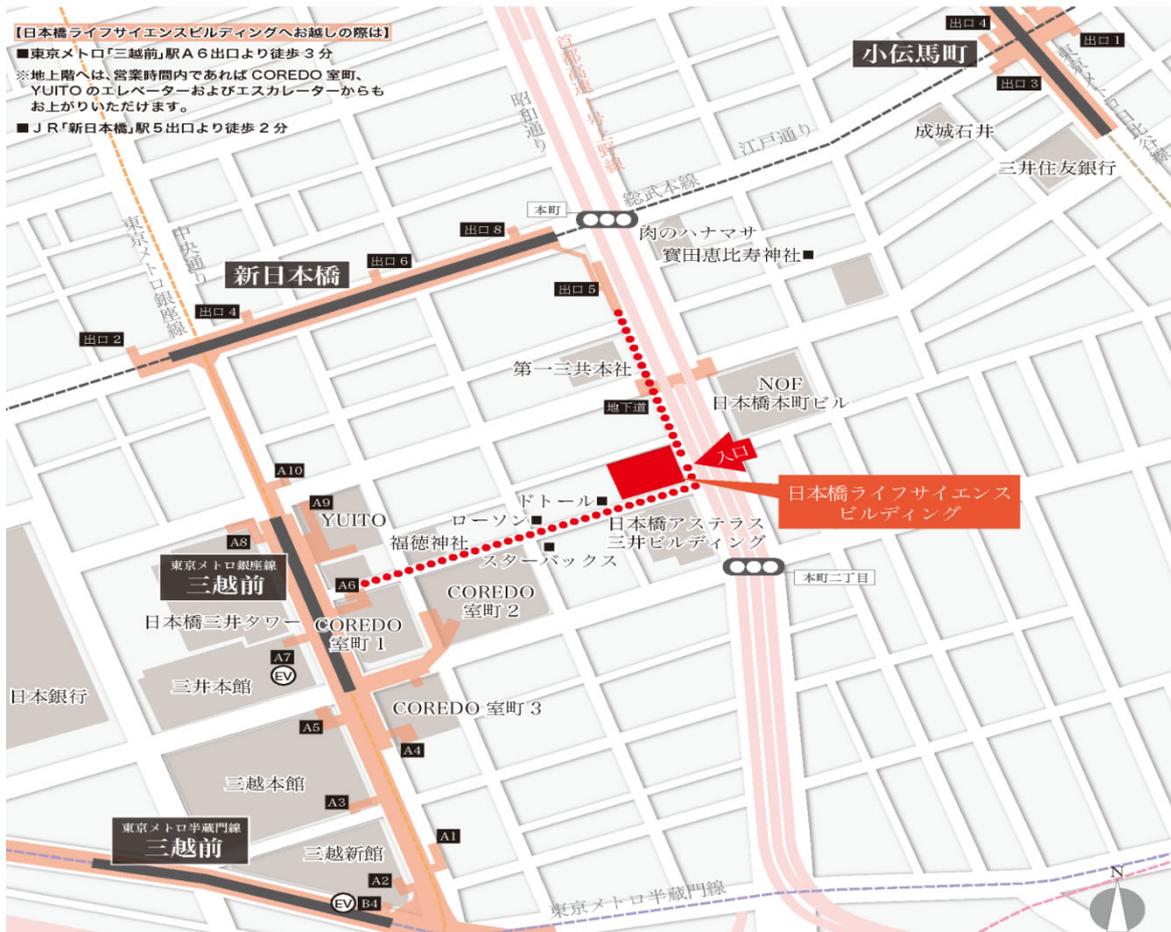
※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

4. 配付資料について

当日の配布資料は委員会開催前にダウンロードシステムを利用し皆様へご送付致します。
開催当日までにご自身にて印刷を行っていただきご準備のうえご参加をお願いいたします。

✓配付資料は各自でご持参ください。会場に紙資料のご用意はございません。

(案内図)



アクセス

- ・東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅A6出口より徒歩3分
- ・JR総武本線「新日本橋」駅 5番出口より徒歩2分
- ・JR各線「神田」駅 南口より徒歩 11分
- ・JR各線「東京」駅 新日本橋口より徒歩 17分